

**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA
FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER LO SVILUPPO DELLA
FACILITY FBK "3D INTEGRATION"**

“LINEA PER ASSOTTIGLIAMENTO WAFERS IN SILICIO”

**Gara telematica Mercurio n. 102614
CUP: B61B19000870005
CIG 8883635F80**

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

L'art. 2 del capitolato speciale – parte tecnica indica che i sistemi devono essere nuovi o EX demo. Sono ammessi alla gara anche strumenti "fully refurbished" con parti nuove ma con main body prodotto in data antecedente ai 5 anni?

RISPOSTA

Gli strumenti vengono richiesti nuovi o ex-demo. Strumenti che hanno parti meccaniche, strutturali e funzionali prodotti in data antecedente ai 5 anni non rispondono ai criteri richiesti dal bando.

QUESITO N. 2

Verranno accettate offerte anche per singoli sistemi oppure la partecipazione alla gara è limitata alla fornitura del cluster? (tape mounter, edge trimmer, grinding, cleaner)

RISPOSTA

Il bando di gara ha ad oggetto la fornitura dell'intero cluster di strumenti. Offerte parziali relative solo ad alcuni strumenti del cluster non sono in linea con quanto richiesto nel bando.

QUESITO N. 3

Foot print per singolo sistema deve essere inferiore a 3 m². Il parametro è da ritenersi valore assoluto o c'è una tolleranza?

RISPOSTA

Il valore è da ritenersi assoluto.

QUESITO N. 4

Con riferimento al processo A1 - Ultratinning: quale è il TTV del wafer di vetro usato come supporto? Le specifiche minime indicano spessore finale di 15 +/-3 micron ed un TTV migliore di 5 micron, che risultano poco compatibili con uno spessore di adesivo variabile tra 15 e 20 micron con TTV \leq 4 micron.

15 - 20 micron di spessore sono da considerarsi il range di spessore dell'adesivo? in tal caso quale è la tolleranza? 15 micron +/-?

RISPOSTA

Il TTV del wafer in vetro borosilicato usato come supporto è \leq 3 μ m.

L'adesivo di bonding è da intendersi con uno spessore medio che nel range 15-20 μ m. Dato lo spessore medio, il TTV sarà \leq 4 μ m.

Le specifiche minime del processo indicano uno spessore finale del solo wafer di silicio di 15 +/-3 μ m (da intendersi come valore medio). Il TTV \leq 5 μ m invece si riferisce a tutto lo stack di wafers (supporto in vetro + adesivo + wafer di silicio assottigliato), come indicato nella tabella a pagina 8 del capitolato speciale – parte tecnica.

QUESITO N. 5

Con riferimento al processo A3: quali sono le specifiche del tape che si prevede di utilizzare a supporto del wafer?

RISPOSTA

Nel capitolato speciale - parte tecnica non viene indicata alcuna specifica sul tape da utilizzare nel processo, che quindi rimane a scelta dell'offerente. Si ritiene inteso che il tape deve essere commercialmente disponibile sul mercato, compatibile con il sistema di tape mounter fornito e deve permettere l'esecuzione del processo di grinding con le specifiche minime indicate, nonché deve poter essere rimosso dal wafer a fine processo senza l'ausilio di altri sistemi ed attrezzature che non siano inclusi nell'offerta.

- Paola Angeli –

Responsabile Servizio Appalti e Contratti

(doc. firmato digitalmente)